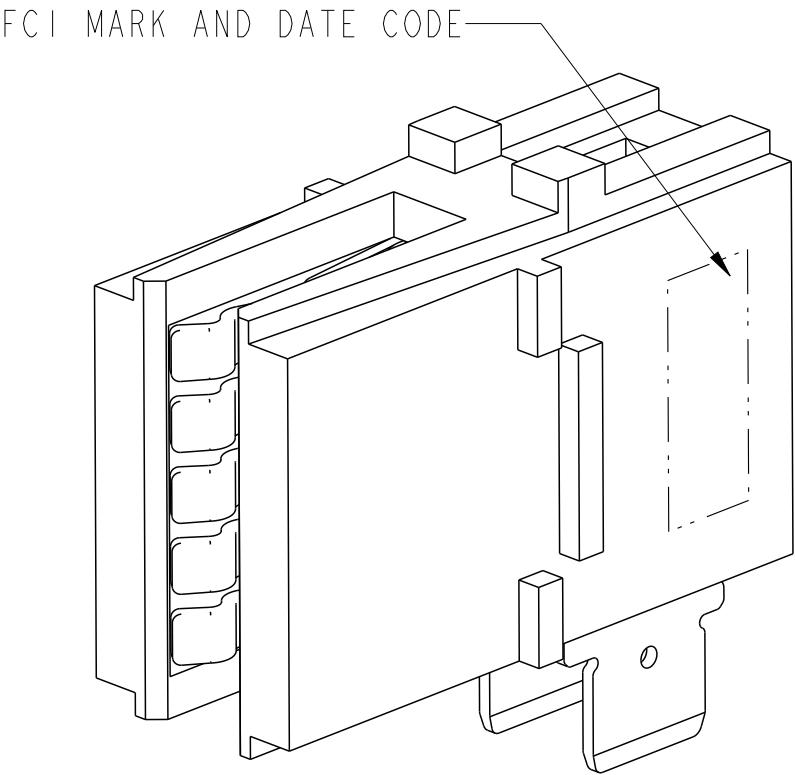
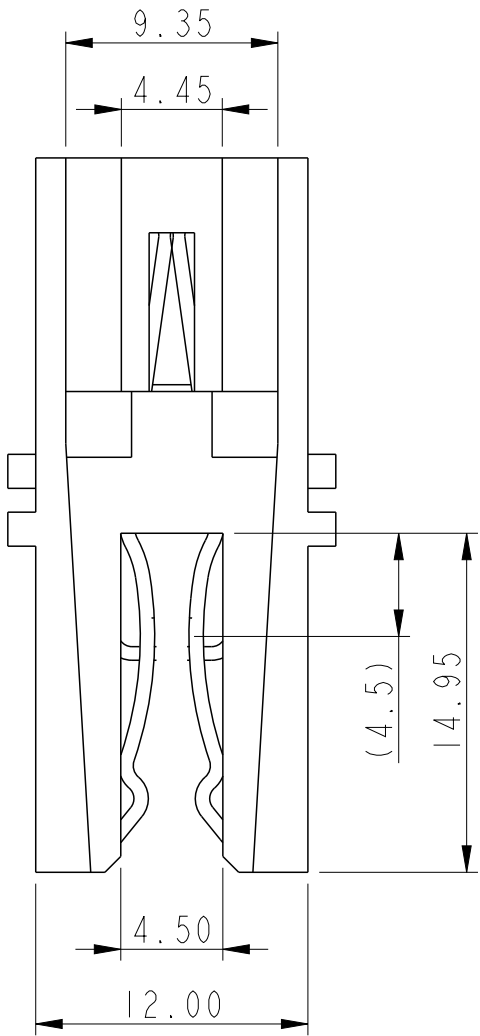
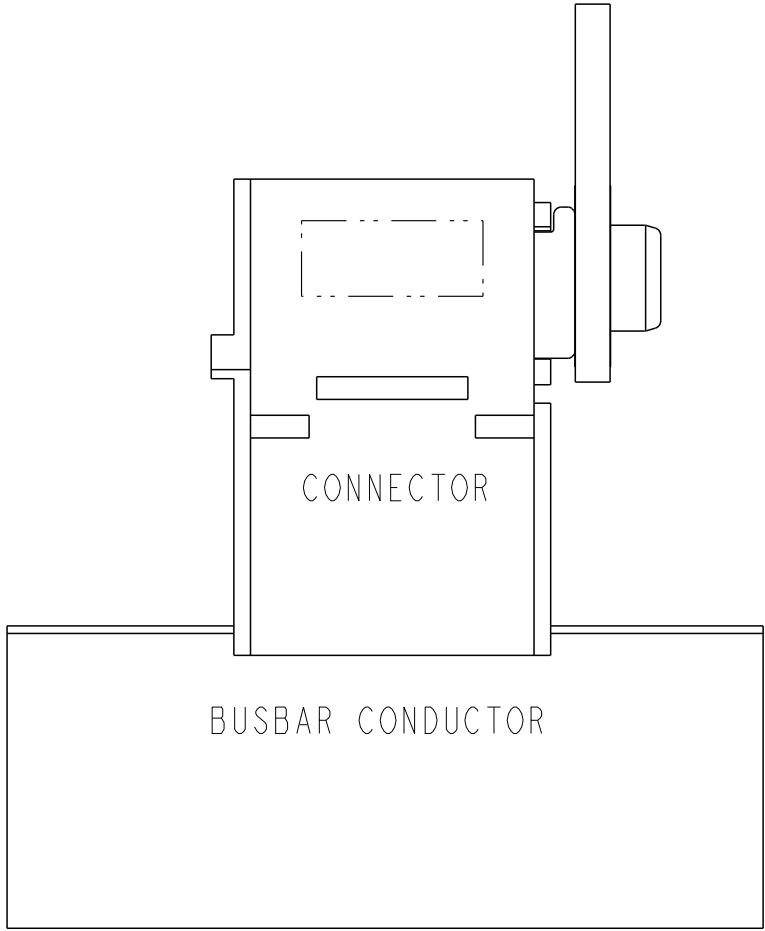
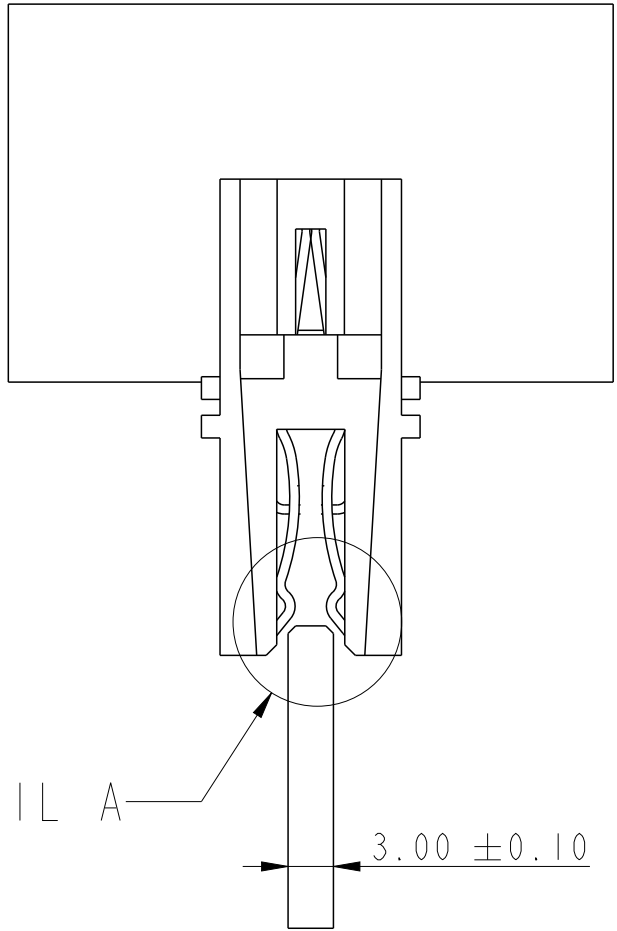
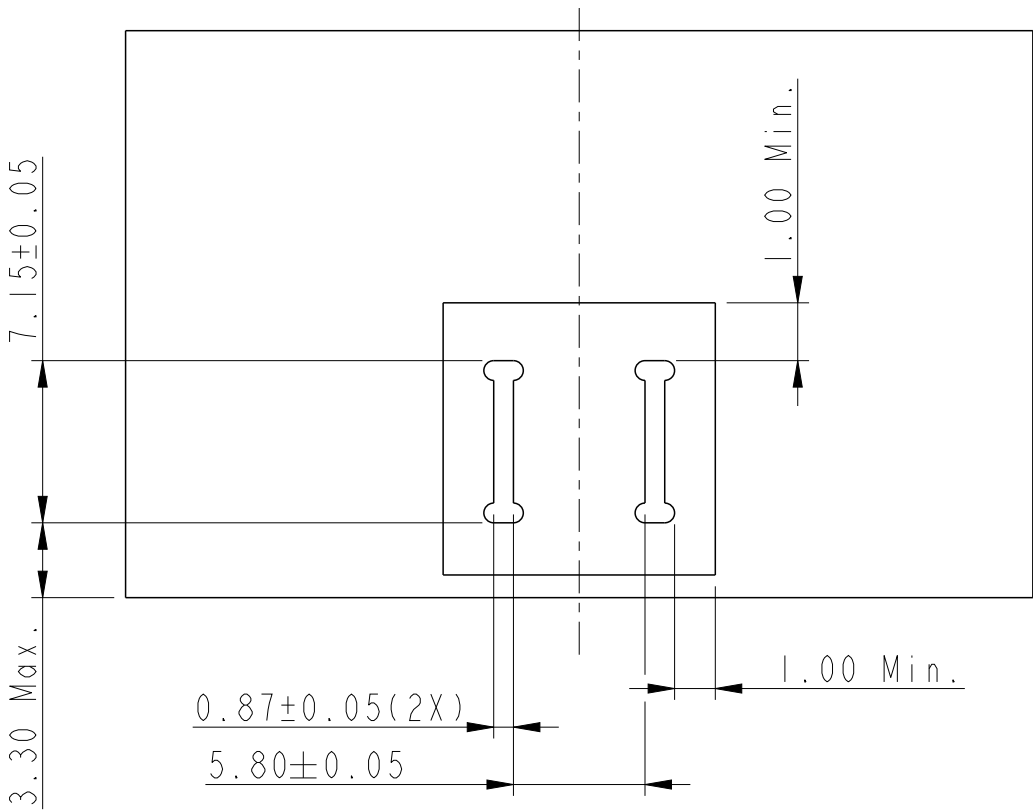
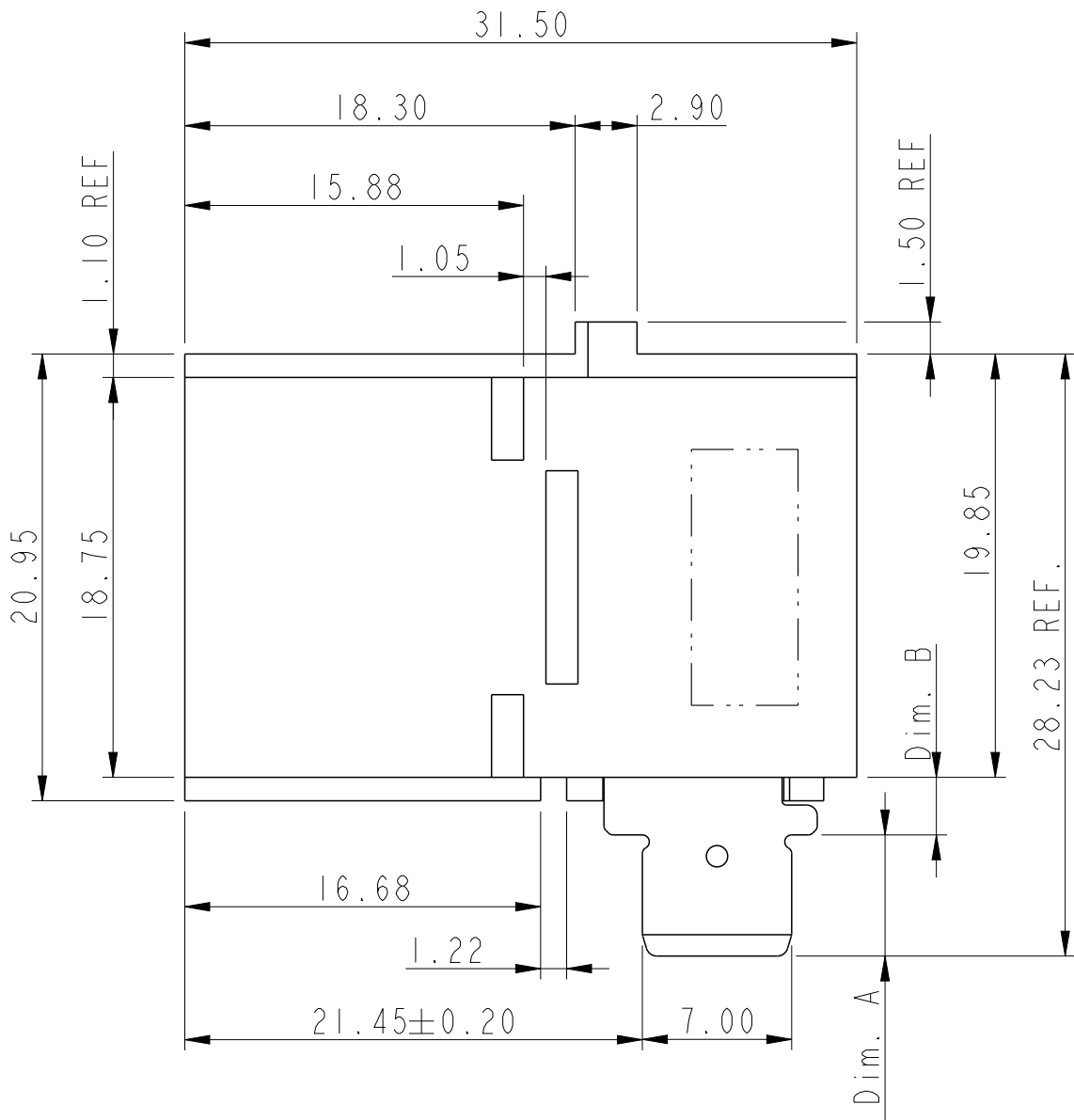
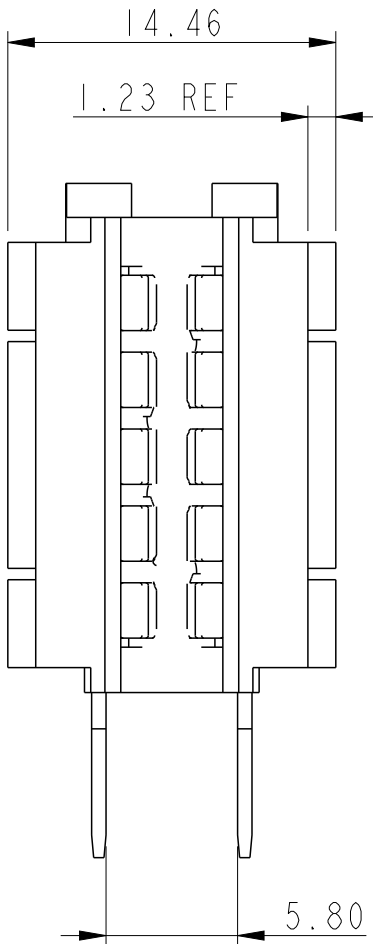
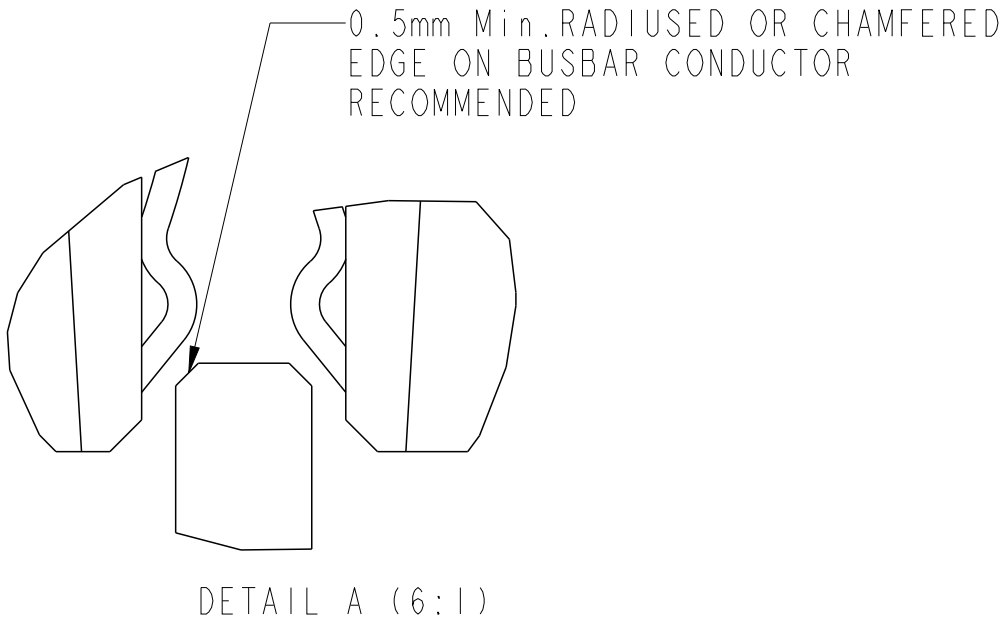


|                |                                                                                                                                              |   |        |        |               |   |   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---------------|---|---|
| 1              | 2                                                                                                                                            | 3 | 4      | 5      | 6             | 7 | 8 |
| PRODUCT NUMBER | DESCRIPTION(PLATING)                                                                                                                         |   | Dim. A | Dim. B | PCB THICKNESS |   |   |
| 10125600-S01LF | CONTACT AREA:AGT PLATING-3.0um SILVER OVER 1.27um NICKEL  |   | 5.68   | 2.70   | 4.80 Max.     |   |   |
| 10125600-S02LF | CONTACT AREA:AGT PLATING-3.0um SILVER OVER 1.27um NICKEL  |   | 4.40   | 4.00   | 2.00 Max.     |   |   |



PCB AND BUSBAR-CONDUCTOR  
IN THESE VIEWS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY.



- NOTES:
- 1.CONNECTOR HOUSING:  
HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC GLASS FILLED, UL 94V-0  
TERMINALS: COPPER ALLOY
  - 2.THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK  
TEMPERATURE FOR 10 SECOND IN A WAVE SOLDER  
APPLANTION WITH CIRCUIT BOARD.
  - 3.FINISHES:  
SEE PRODUCT NUMBER
  - 4.PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-1179  
APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-0396  
PACKING SPECIFICATION: GS-14-2376
  - 5.THE CONNECTOR MUST BE SUPPORTED WITH A FIXTURE  
DURING WAVE SOLDERING PROCESS

RECOMMENDED PCB LAYOUT  
THICKNESS 4.8mm Max.

|               |                                        |                                    |                |            |                |                                     |        |                |          |     |
|---------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------------|--------|----------------|----------|-----|
| spec ref      | -                                      | dr                                 | Zhao Peter     | 2013/06/20 | projection     | MM                                  | size   | A2             | scale    | 3:1 |
| tolerance std | ISO 406<br>ISO 1101                    | eng                                | Jacklin Zou    | 2017/06/22 | chr            | -                                   | ecn no | ELX-DG-27194-1 |          |     |
| surface       | -                                      | appr                               | Pei-Ming Zheng | 2017/06/28 | product family |                                     |        | rel level      | Released |     |
| linear        | 0.X ±0.30<br>0.XX ±0.25<br>0.XXX ±0.10 | <b>Amphenol FCI</b><br>www.fci.com |                | title      |                | Solder Tab<br>Barklip R/A CONNECTOR |        | dwg no         |          | rev |
| angular       | 0° ±2°                                 |                                    |                |            |                |                                     |        |                |          |     |
|               |                                        |                                    |                | cat. no.   |                | Product - Customer Drw              |        | sheet 1 of 1   |          |     |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9